

泰凌微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：泰凌微

证券代码：688591

编号：2026-002

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>中邮电子 万玮 太平基金 徐昊 国投电子 马良 信达澳亚 罗晨熙等</p>
<p>时间</p>	<p>2026年3月1日-4月30日</p>
<p>地点</p>	<p>现场调研、线上会议</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事、总经理：盛文军 副总经理、董事会秘书：李鹏 副总裁：邵磊</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、交流环节：</p> <p>Q1：公司在 AI 和物联网领域的战略转型情况如何？ A1：公司目前正在从纯低功耗无线物联网连接芯片供应商向端侧 AI 智能节点核心芯片平台积极转型，构建连接、计算和软件平台一体化的能力体系。我们推出了多款支持语音处理和传感器数据分析的端侧 AI 芯片，并计划在车规、医疗健康和新型人机交互等领域进行布局。</p> <p>Q2：公司在音频芯片和游戏外设领域的市场前景如何？ A2：音频芯片市场前景看好，特别是 AI 录音产品。近期高端蓝牙音频芯片赛道需求旺盛、增长较好；低端通用蓝牙音频芯片因为市场竞争因素，增速相对一般。游戏外设领域，2026 年 1 月，公司于 CES（全球消费电子展）展出新品 TL322XSoC，该芯片搭载双核处理器、集成 Telink HDT 技术，支持 6Mbps 无线速率，助力游戏外设迈入真 8K 无线时代，已获得国内外一线品牌导入，公司借此有望成为全球无线游戏解决方案的核心供应商之一。</p> <p>Q3：公司一季度利润受哪些因素影响？ A3：2026 年一季度公司扩充 WIFI、Audio 等研发团队规模，叠加多个研发项目有序推进，研发费用增长了约 1511 万元，增幅较大；管理费用增长约 505 万元，主要是并购项目的相关</p>

中介费。基于前述几个核心因素，使得今年一季度的业绩同比表现上有所波动。

Q4: 存储涨价对 IOT 业务的影响如何?

A4: 存储涨价对公司芯片的毛利有一定的直接影响，同时，亦会受到 IOT 终端产品出货量扰动的间接影响，公司也采取了积极应对的相关措施，目前总体看，对公司 IOT 业务的影响是可控的。

Q5: 并购事项进展如何?

A5: 公司并购磐启微事项现正处于上交所受理审核的问询阶段。公司目前正就上交所的问询函件，组织回复工作，该事项尚在正常推进中。

Q6: 公司 H 股上市计划如何?

A6: 公司 H 股上市的计划尚在筹备过程中，具体进展敬请关注后续公告。

Q7: 公司 2025 年分红情况

A7: 公司确定的 2025 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.66 元(含税)，2025 年度利润分配不送红股、不进行资本公积转增股本，拟派发现金红利占 25 年全年实现净利润的近 50%。公司高度重视投资者回报，上市以来，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，以长期回报回馈股东，增强投资者的获得感。

Q8: 公司未来几年的研发投入计划如何?

A8: 公司始终深耕高附加值领域方向，重视研发投入，持续推出高毛利产品逐步占领市场。公司持续推进 55/40/22nm 等多个工艺节点的优化和产品迭代，进一步提升 IOT 产品的性能和优势，完善音频产品矩阵，加速 WiFi 新产品研发，完成超低功耗 NPU 在新产品上的设计和落地，持续关注芯片性能和成本优化。公司未来几年将保持高研发投入，特别是在 AI 和生态系统的建设上。我们认为高投入是保持竞争力的必要条件。

Q9: 公司在端侧 AI 方面的进展

A9: 端侧 AI 的业务发展层面，公司进一步推进“AI+IOT”的产品战略，将边缘 AI 同低功耗无线物联网连接能力相结合，推出支持边缘 AI 技术的多个系列芯片和软件开发工具，公司业务进一步向边缘 AI 方向深化和拓展。公司正逐步形成“连接+端侧 AI 融合”的平台型能力，从“低功耗无线物联网芯片供应商”，向“端侧 AI 智能节点核心芯片平台”升级，逐步构建“连接+计算+软件生态平台”的一体化能力体系，在物联网

	<p>向智能化升级过程中占据独特的战略位置。</p> <p>目前，在端侧 AI 芯片方面，公司 TL721X，TL751X 等系列产品已实现量产，支持智能语音处理、AI 降噪等功能，广泛应用于高端音频应用等场景。该部分业务单芯片价值量（ASP）显著高于传统芯片，毛利率水平相对更高，与 AI 应用结合紧密、具备较强成长性，是公司未来收入增长与盈利能力提升的核心驱动力之一。</p>
上传日期	2026 年 5 月 14 日